

## 「第 72 回大河内記念賞」を受賞

このたび当社は、「半導体封止材等」に使用される真球状微粒子の開発・製造とその事業展開に関する功績が評価され、公益財団法人大河内記念会主催の第 72 回(令和 7 年度)大河内賞(大河内記念賞)を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

なお、贈賞式は 2026 年 3 月 24 日、日本工業倶楽部会館(東京都千代田区丸の内)にて執り行われました。

大河内賞は、「生産のための科学技術の振興」を目的に、生産工学・生産技術分野の研究開発において卓越した成果を挙げた研究者および企業に贈られる、歴史と権威ある賞です。

### 受賞業績の概要

近年の半導体の高密度化・高性能化に伴い、パッケージ材料には、熱膨張差を緩和できる高性能フィラーが強く求められております。従来主流であった大粒径シリカではこれらの要求に対応することが困難となっていました。当社はこの課題に対し、独自の VMC(Vaporized Metal Combustion)法を考案・開発し、既存の量産技術では実現できなかったサブミクロン球状シリカの製造に成功しました。開発から実用化までに約 5 年を要しましたが、量産プロセスの確立とあわせて、新たな市場の創出を実現しています。

VMC 法は、金属シリコン粉末の高温爆燃現象を利用した世界初の量産技術であり、サブミクロン球状シリカを安定かつ効率的に生産可能としました。本技術は高性能半導体向け封止材として高く評価され、現在では関連市場において 7 割を超えるシェアを有し、電子部品分野における不可欠な材料となっています。また、収益性の高い事業として成長を続けており、今後も積極的な設備投資と事業拡大を予定しています。技術開発から量産、さらには市場開拓に至るまで、一貫して高い水準で達成している点が、本受賞において高く評価されました。

当社は本受賞を励みとし、今後も技術革新を通じて半導体産業の発展と社会課題の解決に貢献してまいります。



写真左より種村康成(元常務取締役)、伊藤哲朗(常務執行役員)、安部賛(取締役会長)、中野修(代表取締役社長)、富田亘孝(開発部 部長)

詳細は公益財団法人 大河内記念会の Web サイトをご参照ください。 <https://okoichi.or.jp>